

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2025-008

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币0.84元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。
- 本年度现金分红比例低于30%，主要因为行业特征及公司发展处于成长阶段，研发投入、营运资金投入等所需资金较大。

一、利润分配和送转预案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,674,742,069.87元。

经董事会决议，公司2024年度利润分配预案为：2024年末公司总股本为652,171,706股，其中以集中竞价回购产生的库存股747,700股，2024年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本651,424,006股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.84元（含税），共计人民币54,719,616.50元。

2024年公司以集中竞价方式回购股份747,700.00股，回购股份支付的总金

额为人民币 15,097,492.00 元（不含交易费用）。现金分红和回购金额合计 69,817,108.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 27.62%。

二、本年度利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性说明

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用领域，为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头，封装的产品主要包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用于智能手机、安防监控、汽车电子等应用领域。2024 年随着国际贸易逆全球化、地缘政治博弈的持续演绎加剧，全球经济发展在困境中弱复苏、仍处于低增长状态。半导体行业作为信息社会的战略支柱产业，国际间的博弈激烈程度持续激化，产业链重构趋势加剧演进，尤其在人工智能、生成式 AI 技术为代表的科技创新领域，全球竞争与产业制衡呈现白热化趋势，在此背景下，数据、算力、存储、智能传感等应用市场发展趋势强劲，驱动全球半导体产业规模恢复增长。

面对 2024 年半导体行业及公司所处细分市场的发展趋势，公司持续专注集成电路先进封装技术的开发与服务，通过技术持续创新进一步巩固提升领先优势，有效拓展新的应用市场；积极发展微型光学器件业务，有效提升量产与商业应用规模；持续推进国际先进技术协同整合与产业链拓展延伸，并根据新的产业重构趋势进行全球化的生产、市场与投融资布局。得益于这些举措，公司 2024 年封装测试业务显著增长，尤其在汽车电子应用领域的领先优势不断提升。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告（容诚审字[2025]215Z0344 号），2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 25,275.83 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,652.18 万元，较 2023 年同比分别增长了 68.40%、86.74%。公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 252,758,312.83 元，

2024 年年度分红拟分配的现金红利总额为 54,719,616.50 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 21.65%。2024 年以集中竞价方式回购股份 747,700.00 股，回购股份支付的总金额为人民币 15,097,492.00 元（不含交易费用）。现金分红和回购金额合计 69,817,108.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 27.62%，二者合计占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要基于以下因素：

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于集成电路产业中的封装测试行业，所处行业具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的行业特征。生产所需的机器设备等资本投入规模较大，人力与智力投入大，产业技术创新日新月异，市场需求变化步伐快，需要企业专注主业，通过持续技术创新，加大资本投入、构建核心人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。

（二）公司发展阶段

公司处于成长发展阶段，专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用领域，为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头。封装的产品主要包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用于智能手机、安防监控、汽车电子等应用领域。

2024 年随着国际贸易逆全球化、地缘政治博弈的持续演绎加剧，全球经济发展在困境中弱复苏、仍处于低增长状态。半导体行业作为信息社会的战略支柱产业，国际间的博弈激烈程度持续激化，产业链重构趋势加剧演进，尤其在人工智能、生成式 AI 技术为代表的科技创新领域，全球竞争与产业制衡呈现白热化趋势。在此背景下，公司 2024 年业务规模与盈利能力虽呈现快速增长趋势，尤其在汽车电子应用领域的领先优势不断提升。但为积极应对复杂国际贸易环境、全球产业链重构趋势等相关影响，公司仍需进一步创新提升先进封装技术核心竞争能力，聚焦市场与产品发展需求，不断持续技术服务能力；持续推进产业链延伸拓展与新技术的商业化应用，拓展培育新的业务机会与增长驱动；积极推进海外生产基地的筹划与建设，以更好贴近海外客户需求，推进工艺创新与项目开发，积极融入全球化产业链重构新格局。

（三）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年	2023年	2022年
----	-------	-------	-------

现金分红总额（元）	54,719,616.50	30,020,300.40	45,724,864.22
回购注销股份总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,758,312.83	150,095,690.43	228,443,950.74
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,674,742,069.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	130,464,781.12		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	210,432,651.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	130,464,781.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	62.00		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均达到20%，符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的规定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。

（四）公司未分配利润的主要用途

公司未分配利润的用途将主要用于产业链的延伸拓展、搭建国际业务与投融资平台、加大公司研发投入以及营运资金等方面。

1、产业链延伸拓展

2019年并购荷兰Anteryon公司以来，通过业务、技术的协同整合，公司在微型光学器件领域的业务规模、技术布局取得显著成效，使得光学器件业务已成

为公司整体业务布局的重要组成部分。随着半导体设备、工业智能、汽车智能化的发展趋势，光学器件业务的市场与客户需求持续增长，为有效把握市场机遇，公司将持续加大在该领域的投资与项目拓展。

2021-2022 年，公司投资了以色列 VisIC 公司，拓展布局车用高功率氮化镓技术，以期充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力，把握三代半导体在新能源汽车领域的产业发展机遇。国际化的并购整合、产业链拓展延伸、新技术的商业化开发，均需要相应的资金储备与能力，才能快速抓住行业出现的新机会。

2、持续推进海外生产基地的建设

近年来，国际贸易逆全球化、地缘政治博弈持续加剧，集成电路产业作为数字经济时代的战略性基础产业，已成为国际竞争的战略焦点，全球产业链正在发生重组整合，为有效应对产业链的发展新趋势，着眼于未来的持续发展布局，2024 年公司持续推进国际业务与投融资平台的搭建，并在马来西亚槟城筹划建设海外生产制造基地，以更好贴近海外客户需求，推进工艺创新与项目开发。国际业务与投融资平台的搭建、海外生产制造基地的建设，需要相应的资金支持与保障。

3、持续加强研发投入

公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完善。公司成立以来，始终注重技术的研发投入与持续创新，一步步发展为全球传感器领域先进封装技术的引领者，2022 年、2023 年以及 2024 年公司的研发费用分别达 1.93、1.36 和 1.60 亿元，占公司销售收入的比重分别为 17%、15%、14%，2025 年公司仍需保持对研发的持续投入，通过对技术、工艺的持续创新开发，顺应并把握不断变化的市场需求。

4、满足业务拓展的营运资金需要

近年来随着汽车智能化的快速发展趋势，车载 CIS 为代表的智能传感器市场迎来发展机遇，公司作为车载 CIS 芯片领域晶圆级 TSV 封装技术的领先者，将积极聚焦供应链资源、加大生产投入，把握业务机会，从而相应需要营运资金的投入与协同支持。

因此，公司将留存未分配利润用于产业链延伸拓展、推进海外生产基地建设、

研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届监事会第六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红》、《公司章程》等关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025年4月19日